

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2013 年 9 月 19 日(19.09.2013)



(10) 国際公開番号

WO 2013/136769 A1

- (51) 国際特許分類:
C08G 59/18 (2006.01) C08G 59/62 (2006.01)
C08G 59/06 (2006.01) C08G 59/68 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2013/001590
- (22) 国際出願日: 2013 年 3 月 12 日(12.03.2013)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2012-060748 2012 年 3 月 16 日(16.03.2012) JP
特願 2012-207668 2012 年 9 月 21 日(21.09.2012) JP
- (71) 出願人: 住友ベークライト株式会社(SUMITOMO BAKELITE CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川 2 丁目 5 番 8 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 田部井 純一(TABEI, Jun-ichi); 〒8220006 福岡県直方市大字上境字水町 4 0-1 九州住友ベークライト株式会社内 Fukuoka (JP).
- (74) 代理人: 速水 進治(HAYAMI, Shinji); 〒1410031 東京都品川区西五反田 7-9-2 五反田 T G ビル 9 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: SEALING RESIN COMPOSITION AND ELECTRONIC DEVICE USING SAME

(54) 発明の名称: 封止用樹脂組成物およびこれを用いる電子装置

(57) Abstract: Provided are: a resin composition for sealing electronic components which comprises a phenol resin curing agent, an epoxy resin, and a mold releasing agent with a 5% weight loss temperature of 240°C or more; a resin composition for sealing electronic components which comprises an epoxy resin and a mold releasing agent with a 5% weight loss temperature of 240°C or more; a sealing resin composition for sealing electronic components which comprises a phenol resin curing agent, an epoxy resin, and a mold releasing agent with a 5% weight loss temperature of 240°C or more, the glass transition temperature (T_g) of a cured product of the sealing resin composition being 200°C or more, and the weight loss rate of the cured product when heated in an ambient atmosphere at 200°C for 1,000 hours is 0.3% or less; and an electronic device which comprises electronic components that are sealed with said resin composition.

(57) 要約: 本発明によれば、フェノール樹脂硬化剤と、エポキシ樹脂と、5%重量減少温度が240°C以上の離型剤とを含む電子部品封止用の樹脂組成物、エポキシ樹脂と5%重量減少温度が240°C以上の離型剤とを含む電子部品封止用の樹脂組成物、フェノール樹脂硬化剤と、エポキシ樹脂と、5%重量減少温度が240°C以上の離型剤とを含む封止用樹脂組成物であって、封止用樹脂組成物の硬化物のガラス転移温度(T_g)が、200°C以上であり、硬化物の、大気雰囲気下、200°Cで1000時間加熱したときの重量減少率が、0.3%以下である、電子部品封止用の封止用樹脂組成物、ならびに上記樹脂組成物で封止された電子部品を備える電子装置が提供される。

WO 2013/136769 A1